

中信建投证券股份有限公司

关于

**硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市**

之

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况	5
二、发行人本次发行情况	15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式	17
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项	20
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明	21
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程	21
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明	23
九、持续督导期间的工作安排	27
十、保荐人关于本项目的推荐结论	27

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、硅数股份	指	硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海鑫锚、第一大股东	指	上海鑫锚企业管理咨询有限公司
集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
上市保荐书	指	中信建投证券出具的《中信建投证券股份有限公司关于硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
发行人会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程（草案）》	指	《硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司章程（草案）》
《审计报告》	指	信永中和为本次发行及上市于 2023 年 5 月 10 日出具的标准无保留意见的“XYZH/2023BJAA1B0272”号《审计报告》
内部控制鉴证报告	指	信永中和出具的《内部控制鉴证报告》（XYZH/2023BJAA1B0273 号）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
Fabless	指	Fabrication-Less，即无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商专注于芯片的研发、设计与销售，而将晶圆制造、封装和测试环节委托给专业厂商完成
EDA	指	Electronic Design Automation，即电子设计自动化，主要是指用来支持集成电路芯片设计的自动化软件工具
Cadence	指	楷登电子（Cadence Design System, Inc.）是一家专门从事电子设计自动化的软件公司
Synopsys	指	新思科技（Synopsys Technologies Company Limited）是一家电子设计自动化解决方案提供商
TCON 芯片、显示主控芯片	指	Timing Controller 芯片，显示面板时序控制器芯片，能够将从外部供给的数据信号、控制信号以及时钟信号分别转换成适合于驱动 IC 的数据信号、控制信号、时钟信号，实现色度控制和时序控制
Repeater 芯片	指	中继器芯片，主要用于解决信号高速传输过程中的衰减问题，Repeater 芯片又可以分为 Re-driver 芯片和 Re-timer 芯片两类
Controller 芯片	指	端口控制芯片，主要用于控制接口识别及充电电压电流
Converter 芯片	指	协议转换芯片，主要用于不同传输协议之间的转换

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后

尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称:	硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司
注册地址:	苏州市高新区竹园路 209 号 4 号楼 1801
成立时间:	2016 年 09 月 28 日
注册资本:	36,000.00 万元人民币
法定代表人:	LI XUDONG（李旭东）
董事会秘书:	张鹏
联系电话:	010-68917809
互联网地址:	https://www.analogix.com/cn
主营业务:	硅数股份是一家提供高性能数模混合芯片的企业。公司在高速 SerDes 信号传输及处理技术、数模混合电路设计技术、高清显示技术、协议转换技术等领域拥有深厚的技术积累，且已建立以显示主控芯片、高速智能互联芯片为主要产品的集成电路芯片研发与销售业务，以及为国际知名半导体厂商提供 IP 授权及芯片设计服务业务。公司已开发的产品覆盖 DP、eDP、USB、HDMI、MIPI 等高速信号传输协议，能够实现在个人电脑、显示器、VR/AR、汽车电子、视频会议系统等多元化的终端场景的高清显示和高速智能互联全覆盖解决方案
本次证券发行的类型:	首次公开发行普通股并在科创板上市

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

硅数股份是一家提供高性能数模混合芯片的企业。经过二十年的研发、探索与创新，公司在高速 SerDes 信号传输及处理技术、数模混合电路设计技术、高清显示技术、协议转换技术等领域拥有深厚的技术积累，且已建立以显示主控芯片、高速智能互联芯片为主要产品的集成电路芯片研发与销售业务，以及为国际知名半导体厂商提供 IP 授权及芯片设计服务业务。公司已开发的产品覆盖 DP、eDP、USB、HDMI、MIPI 等高速信号传输协议，能够实现在个人电脑、显示器、VR/AR、汽车电子、视频会议系统等多元化的终端场景的高清显示和高速智能互联全覆盖解决方案。

硅数股份是行业技术的先行者，早在 2003 年就推出首颗 D-PHY 6.25G SerDes 芯片、于 2006 年就采用 DP 标准开发芯片；2010 年推出的 eDP 显示主控芯片被苹果 MacBook Air 采用、于 2015 年推出全功能 USB Type-C 芯片、于 2016

年推出支持 VR 显示的高速协议转换芯片、于 2018 年推出首颗 28nm 工艺显示主控芯片、于 2021 年推出首颗 22nm 显示主控芯片和 14nm 应用于 AR/VR 的高速协议转换芯片、于 2022 年向国际知名的半导体厂商提供 8nm DP2.1 的相关 IP。公司参与国际多个主流信号传输协议的制订和更新，是 DP 及 eDP 传输协议标准的主要制定者和传输标准演进、更新的贡献者，是 USB 传输标准的制定和标准演进、更新的重要参与者和贡献者，也是 HDMI 标准解决方案的重要提供者，并参与制定了最新 USB PD3.1 快充标准。公司对上述标准的深刻理解也为公司的产品开发和不断创新奠定了底层技术优势。公司产品及技术能够达到世界一流水平，为我国集成电路设计行业的进步发挥了示范带动作用，为促进我国集成电路产业链的发展做出了积极贡献。

公司拥有丰富的产品线、深厚的技术储备以及较强的定制化方案开发能力，与客户构建了牢固的合作关系。公司凭借自身的技术优势为 LG、夏普、京东方、华星光电等一线面板厂商，富士康、仁宝、广达等知名消费电子终端代工商，戴尔、微软、惠普、联想、谷歌等国际知名品牌商提供了芯片产品，也基于公司在 DP、eDP 等传输协议或行业标准方面的技术实力，为三星、苹果等国际知名消费电子厂商提供 IP 授权和芯片设计服务。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产	225,444.83	133,624.73	33,874.38
非流动资产	118,595.79	108,258.51	101,838.34
资产合计	344,040.62	241,883.23	135,712.72
流动负债	15,336.67	20,309.82	15,881.33
非流动负债	6,230.56	6,173.57	2,036.67
负债合计	21,567.23	26,483.39	17,918.00
归属于母公司所有者权益	322,473.38	215,399.85	117,794.72

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
营业收入	89,528.51	84,035.84	65,547.18
营业利润	11,467.39	8,167.30	2,682.04
利润总额	11,468.36	8,167.32	2,682.04
净利润	11,287.08	7,984.70	2,566.57
归属于母公司所有者的净利润	11,287.08	7,984.70	2,566.57
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,838.67	9,359.28	1,286.97

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
经营活动产生的现金流量净额	3,365.65	17,404.18	7,094.63
投资活动产生的现金流量净额	-96,918.63	-6,781.93	-4,962.48
筹资活动产生的现金流量净额	90,318.84	81,411.33	2,644.83
现金及现金等价物净增加额	-980.91	91,278.69	3,243.71

4、主要财务指标

主要财务指标	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
流动比率（倍）	14.70	6.58	2.13
速动比率（倍）	12.70	5.71	1.24
资产负债率（合并）	6.27%	10.95%	13.20%
资产负债率（母公司）	2.85%	4.50%	6.64%
应收账款周转率（次）	8.70	7.49	6.31
存货周转率（次）	1.64	2.31	3.21
息税折旧摊销前利润（万元）	20,609.75	14,798.71	8,207.39
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	11,287.08	7,984.70	2,566.57
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,838.67	9,359.28	1,286.97
研发投入占营业收入的比例	28.04%	28.49%	23.09%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.09	-	-
每股净现金流量（元/股）	-0.03	-	-

主要财务指标	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.96	-	-

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债=（流动资产－存货） / 流动负债；
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产；
- 4、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额；
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销；
- 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末普通股数量；
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末普通股数量；
- 9、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东的净资产 / 期末普通股数量。

（四）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）销售、客户、经营业绩相关的风险

1) 业绩波动的风险

2020年度、2021年度及2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,566.57万元、7,984.70万元和11,287.08万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,286.97万元、9,359.28万元和5,838.67万元，业绩有一定波动，主要系受行业发展情况、市场竞争格局、产品销售价格及毛利率变化等因素的影响。2022年下半年以来半导体行业产能紧张状态逐步缓解，芯片产品整体市场价格普遍呈回落趋势，同时半导体行业需求整体放缓，并呈现出结构化特征，公司面向消费电子领域的产品市场呈现了不同的供需发展态势，部分细分领域存在一定的库存消化压力，此外地缘冲突以及全球经济发展放缓等因素加大了市场增长的不确定性，公司下游客户下单和提货趋于谨慎。

发行人产品主要用于个人电脑等消费电子领域，整体而言，公司业务规模增长受下游需求增长影响较大，若整体宏观经济及半导体行业持续波动、产业政策发生重大不利变化，公司产品涉及的应用需求下降，如果公司未能及时判断下游需求变化，可能对公司的销售收入和经营业绩产生不利影响。同时，产品和技术升级迭代及市场竞争格局变化也将对发行人业绩产生影响，若公司技术迭代不及市场需求、市场竞争加剧或市场环境发生重大不利变化，可能导致公司出现产品

售价下降、销售量降低等不利情形，致使公司未来业绩可能发生波动。

2) 客户相对集中风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入金额分别为 53,463.04 万元、70,254.92 万元和 71,481.47 万元，占主营业务收入的比例分别为 81.67%、83.69% 和 79.84%，客户集中度较高，其中第一大客户 LG 收入占比分别为 29.38%、42.75% 和 41.03%。如果未来公司主要客户的经营、采购战略产生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，且未能及时获取新替代客户承接下游需求，将对公司经营产生不利影响。

3) 毛利率波动风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.52%、53.89% 和 50.95%，存在一定波动，主要是受产品结构、产品售价及生产成本等因素的影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司迭代不及市场需求，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、低毛利率产品收入占比提高等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

4) 汇兑损益风险

公司存在境外销售和采购的情形，并主要通过美元进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临汇兑损益风险。报告期内，公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为 188.32 万元、149.95 万元和 1,719.09 万元（正数表示汇兑收益），总体上对公司经营业绩的影响较小。如果未来公司境外业务进一步发展，国际合作程度加深，公司将面临因汇率出现不利变化而对公司经营业绩产生不利影响的风险。

5) 应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 9,307.57 万元、13,141.46 万元和 7,436.51 万元。报告期各期末应收账款账面余额占当期营业收入的比例为 14.20%、15.64% 和 8.31%。如果未来宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而增

加坏账损失的风险。

(2) 生产、存货相关的风险

1) 供应商集中度较高和供应商产能波动的风险

公司采用 Fabless 模式经营，主要进行集成电路的设计和 sales，晶圆的制造、封装和测试等生产环节主要由专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商来完成。公司目前已经和国内外晶圆代工厂、封测厂建立了稳定、良好的合作关系，但由于晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，公司供应商本身行业集中度较高，相应地导致公司供应商集中度也较高。报告期内，公司向前五大供应商合计采购的金额分别为 36,058.76 万元、34,961.27 万元和 48,809.37 万元，采购占比分别为 94.96%、95.62% 和 97.46%，供应商集中度较高。若晶圆市场价格、外协加工费价格大幅上涨，或由于晶圆供货短缺、供应商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。

2) 存货余额较大及跌价风险

公司主要根据客户的预计需求、上游产能情况、公司库存情况等制定采购和生产计划，并根据市场变化动态调整备货水平。由于芯片生产周期较长且上游供应商较为集中，在业务规模不断扩大和上游产能紧张的情况下，公司通常会加大备货，使得存货余额随着业务规模的不断扩大而增加。报告期各期末，公司存货账面余额分别为 15,044.17 万元、18,556.20 万元和 35,051.60 万元，存货跌价准备计提比例（不含合同履约成本）分别为 7.95%、7.17% 和 12.87%。公司产品的下游应用领域以个人电脑等消费电子应用领域为主，下游市场产品和技术更迭较快，如果未来公司因客户需求变化、未能准确判断下游需求等原因使得公司存货无法顺利销售，或出现市场竞争加剧、公司不能有效维持竞争优势等原因，使得产品价格显著下跌，将增加存货跌价准备风险。

(3) 研发与技术相关风险

1) 新产品研发及技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。这要求公司对于技术发展趋势和市场需求拥有准确及快速的把握，对于产品定位具有

敏锐的判断，同时拥有强大的研发能力。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度减缓，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，如果公司在研发过程中出现某些关键技术未能及时突破，或者研发成果未能及时实现产业化，或产品无法满足市场需要，将导致公司面临研发失败的风险，对公司经营业绩会产生不利影响。

2) 核心技术泄密风险

经过二十年来持续的技术积累，公司储备了一系列拥有自主知识产权的核心技术。为保障经营过程中所积累多项专利及专有技术的保密性与安全性，公司通过严格执行研发全过程的规范化管理、申请集成电路布图设计专有权及发明专利保护等相关措施避免技术失密。此外，公司还与主要技术人员签订了保密合同，防范核心技术机密的外泄。

然而，上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况。一旦核心技术失密的情况出现，将可能给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

3) 存在知识产权被侵权的风险

公司坚持自主创新的研发战略，经过多年的技术开发和业务积累，拥有多项核心技术。公司建立了完善的知识产权维护机制以保护公司的知识产权免受侵犯。但是考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生，从而导致公司制止侵权行为产生额外费用，对公司正常业务经营造成不利影响。同时，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，以开发自有、底层技术为主要研发路线，以避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展的风险。

(4) 其他经营和管理风险

1) 无控股股东及实际控制人风险

公司股权较为分散，无控股股东及实际控制人。截至本招股说明书签署日，公司的前两大股东分别为上海鑫锚和集成电路基金，分别持有公司 17.74% 和 14.31% 的股份。公司单个股东单独或者合计持有的股份数量均未超过公司总股本

的 30%，单个股东均无法决定董事会多数席位，公司经营方针及重大事项的决策均由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能。但由于公司股权较为分散，在公司股东的意见出现重大分歧等极端情况下，存在公司董事会和股东大会决策效率较低以及控制权发生变动的风险，从而导致公司正常经营活动受到影响。

2) 商誉及无形资产减值风险

2017 年，发行人收购硅数美国 100% 股权属于非同一控制下企业合并，确认了大额的商誉，并按照评估的公允价值识别了大额的无形资产-商标、无形资产-专利及专有技术。2022 年末，发行人商誉、无形资产-商标、无形资产-专利及专有技术的账面价值分别为 62,292.56 万元、28,415.53 万元和 1,207.37 万元。上述商誉及无形资产合计金额较大，如果未来出现宏观经济下行、市场环境剧烈变化、产业政策调整等事项，且发行人未能采取积极有效措施进行应对，或发行人自身出现经营效率降低、研发进展不顺利、产品竞争力减弱等情况，则存在进一步计提商誉及无形资产减值的风险，可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

3) 海外经营的风险

报告期内，公司在中国大陆以外的中国香港、美国、开曼、韩国设有境外经营主体。境外经营主体所在国家及地区的政策、法律法规、经营环境与境内均存在差异，公司对其进行经营管理时需充分了解相关国家和地区的监管政策、汇率波动、法律法规及其它要求。虽然公司的境外业务已存续多年，境外经营经验已经相对成熟，但公司仍存在无法适应境外相关国家和地区新的法律法规或监管环境变化、境外经营管控体系无法有效运行的风险，公司生产经营或将受到不利影响。

4) 税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司享受的税收优惠金额分别为 417.99 万元、4,112.04 万元及 3,186.68 万元，占同期利润总额的比例分别为 15.58%、50.35% 和 27.79%。发行人作为国家鼓励的重点集成电路设计企业，2021 年度享受免征企业所得税，2022 年享受企业所得税税率为 10%；硅数北京作为高新技术企业，报告期内可享受企业所得税税率为 15%；公司的出口应税收入采用“免、抵、退”办法，按照国家

规定的退税率退税；发行人、硅数北京享受研发费用加计扣除优惠。若国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业认定，则可能面临因税收优惠减少或取消而导致盈利能力下降的风险。

5) 募投项目风险

本次募集资金投资项目主要为高清显示技术研发及产业化项目、智能连接芯片研发及产业化项目以及研发中心建设项目，募投项目的实施将对公司的发展战略和业绩水平产生重大影响。公司在本次发行前已对募投项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，但该研究主要基于当前产业政策、市场环境和技术水平等因素作出。若在项目实施过程中技术研发成果、投资成本等客观条件发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实施、研发产品是否能够成功上市并实现产业化、项目经济效益是否能够符合预期将存在不确定性。此外，本次发行的募投项目投资总额合计超 15 亿元，金额较大且在短期内难以完全产生效益，而募投项目产生的研发费用、设备折旧等短期内会大幅增加，公司将面临较大的业绩压力。如果未来募投项目实施后，公司经营业绩不达预期或市场环境发生重大不利变化，公司销售订单和营业收入不能在预期时间内随之提高，公司将面临因募投项目实施导致业绩大幅下滑，甚至产生亏损的风险。

2、与行业相关的风险

(1) 半导体行业周期性波动风险

公司所处的半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，与宏观经济及下游应用市场需求波动、半导体行业供需关系变化有较大关联。

受世界经济呈现衰退态势、消费电子周期需求下行、国际地缘政治复杂多变等多重影响，2022 年以来半导体行业进入新一轮下行周期。公司产品下游应用领域包括个人电脑等消费电子领域，终端市场需求受到本轮半导体下行周期及宏观经济形势影响。

如果未来集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化，或半导体行业下行周期出现持续时间较长、波动较大的情况，则公司的经营业绩可能下滑甚至亏损。

（2）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、中美贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

公司目前已建立起国际化的委托生产与销售布局，未来国际贸易环境若发生重大不利变化，例如出现贸易摩擦不断升级，晶圆代工等出现供应短缺、价格大幅上涨、进口限制等情形，则公司的采购业务将受到相应冲击，进而导致公司的正常生产经营活动受到不利影响。

（3）市场竞争加剧风险

公司业务所处领域整体有较高的技术壁垒，需要长时间的技术积累。而中国大陆企业在该领域起步相对较晚，目前市场竞争格局仍主要由境外公司所主导。公司相较于海外领先竞争对手，虽在技术积累、研发能力等方面具备竞争实力，但在整体规模、营销网络、客户资源、融资渠道等诸多方面仍存在差距。随着中国大陆半导体产业整体设计能力的进步，公司也会面临本土芯片设计公司在细分产品市场的竞争。

在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，竞争决策失误、市场拓展不力，则公司的市场地位与经营业绩等可能受到不利影响。

（4）技术授权风险

集成电路设计企业在经营和技术研发过程中，为加快研发速度、缩短设计周期，一般均会视需求向 IP 供应商购买 IP 授权，向 EDA 工具供应商采购 EDA 设计工具。公司作为采用 Fabless 模式的典型集成电路设计企业，主要从 Cadence、Synopsys 等获取 EDA 设计工具授权。EDA 设计工具供应商集中度较高主要系受集成电路行业中 EDA 设计工具市场寡头竞争格局的影响。如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，致使上述 EDA 设计工具供应商

均不对公司进行技术授权，发行人需要选择其他供应商作为替代。发行人利用新的 EDA 设计工具进行新产品的研发生产需要一定的周期，因而发行人存在由于替代 EDA 设计工具无法及时衔接影响芯片产品研发的风险，可能对公司的经营产生不利影响。

(5) 吸引人才与保持创新能力的风险

作为知识密集型行业企业，发行人对于研发人才、产业人才和管理人才的依赖程度较高。一方面，为了适应日新月异的产业革新及满足下游客户的需求，企业研发人员需要具备微电子、计算机、通信及材料科学等复合知识背景且拥有快速响应的能力；另一方面，在芯片产业化过程中，公司不仅需要根据行业内变化作出前瞻性判断，还需要与晶圆加工、测试、封装等各环节合作伙伴保持良好的合作关系，这对于管理化、产业化人才也提出了更高的要求。

目前国内芯片设计行业发展迅速，企业间对上述人才的竞争十分激烈。如果公司不能制订出良好的人才激励政策，或者人力资源管理不能适应快速发展的需要，将面临核心人才流失的风险，同时也可能陷入难以吸引优秀人才加盟的境地，从而导致公司无法保持持续的创新能力。

二、发行人本次发行情况

本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 4,001 万股	占发行后已发行股份总数比例	不低于 10%
其中：发行新股数量	不超过 4,001 万股	占发行后已发行股份总数比例	不低于 10%
股东公开发售股份数量	-	占发行后已发行股份总数比例	-
发行后总股本	不超过 40,001 万股		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）	发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较

			低者除以本次发行前已发行股份总数计算)
发行后每股净资产	【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算)	发行后每股收益	【】元(以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算)
发行市净率	【】倍(按发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销方式		
拟公开发售股份股东名称	本次发行不涉及股东公开发售		
发行费用的分摊原则	本次发行不涉及股东公开发售,不涉及发行费用分摊,发行费用全部由发行人承担		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	扣除新股发行费用后,募集资金净额【】元		
募集资金投资项目	高清显示技术研发及产业化项目		
	智能连接芯片研发及产业化项目		
	研发中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元,其中:(1)承销费及保荐费【】万元(2)审计费【】万元(3)律师费【】万元(4)其他【】万元		
本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】		
开始询价推介日期	【】		
刊登定价公告日期	【】		
申购日期和缴款日期	【】		
股票上市日期	本次股票发行结束后,将尽快按照程序向上交所申请股票上市		

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行的保荐代表人

中信建投证券指定张林、侯顺担任本次硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司首次公开发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

张林先生：保荐代表人，博士学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：七星电子 IPO、中国核电 IPO、筑博设计 IPO、复旦微电 IPO、中芯国际 IPO、燕东微 IPO、北方华创非公开发行、七星电子非公开发行、东方精工非公开发行、紫光股份非公开发行、铁汉生态非公开发行、泛海控股非公开发行、科蓝软件可转债、中航动力发行股份购买资产并募集配套资金、民生控股重大资产出售、七星电子发行股份购买资产并募集配套资金、华美地产公司债等，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行并于创业板上市（已注册），在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

侯顺先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：筑博设计 IPO、燕东微 IPO、航天南湖 IPO、科蓝软件可转债、联络互动重大资产重组、汇鸿股份换股吸收合并、京城股份重大资产重组、常林股份重大资产重组、国机重装重大资产重组、苏美达公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为李梦莹，其保荐业务执行情况如下：

李梦莹女士：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：金凯生科 IPO（已注册）、煜邦电力 IPO、筑博设计 IPO、北方华创非公开、紫光股份非公开、节能铁汉向特定

对象发行股票项目、科蓝软件可转债、创智科技定向增发、创智科技重新上市、中航沈飞重组上市、石榴置业公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括曹东明、闫思宇、詹明儒、李笑彦、高诚伟、田东阁。

曹东明先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：金凯生科 IPO（已注册）、筑博设计 IPO 项目、北方华创非公开发行项目、科蓝软件可转债、苏美达公司债项目、亦庄控股协议收购麦克奥迪项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

闫思宇先生：硕士研究生，具有中国注册会计师资格，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：复旦微电 IPO、燕东微 IPO、筑博设计 IPO、金凯生科 IPO（已注册）、北方华创非公开发行、置信电气发行股份购买资产、科蓝软件可转债、北方华创股权激励等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

詹明儒先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：金凯生科 IPO（已注册）、科蓝软件可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李笑彦先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：北方华创非公开、国机集团要约收购、二重重装主动终止上市、中国电建重大资产重组、常林股份重大资产重组、南洋科技重大资产重组、国机重装重大资产重组、筑博设计 IPO、燕东微 IPO 等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

高诚伟先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管

理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：桂发祥 IPO、博天环境 IPO、燕东微 IPO，中国核建可转债、南方航空非公开、赞宇科技非公开及股权激励、中节能集团绿色公司债、中国诚通公司债、国电投公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

田东阁先生：硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：燕东微 IPO、置信电气重大资产重组、京城股份发行股份购买资产、二重重新上市、铁汉生态非公开、科蓝软件可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
邮编：	100101
联系电话：	010-65608236
传真：	010-85130300

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其第一大股东、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人中信建投证券系发行人股东合肥润信的执行事务合伙人中信建投资本管理有限公司的母公司，合肥润信持有发行人 0.87% 股份。

截至本上市保荐书签署日，保荐人中信建投证券与发行人股东青岛桐曦的执行事务合伙人信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司存在关联关系，青岛桐曦持有发行人 1.54% 股份。

除前述情形外，截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其第一大股东、重要关联方股份的情况；

保荐人将根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、

法规的规定安排相关方参与本次发行战略配售；

（二）发行人或其第一大股东、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其第一大股东及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人第一大股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其第一大股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

(八)自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(九)中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等相关议案，并决定提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

2022 年 12 月 20 日，发行人召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等相关议案。

发行人于 2023 年 5 月 8 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等相关议案。

经核查，本保荐人认为发行人已就本次发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

保荐人查阅了发行人所在行业的相关产业政策、行业研究报告、同行业公司的公开资料，了解行业技术发展情况、同行业公司的技术方向、国家战略方向、市场竞争情况；获取了发行人报告期内产品销售情况，复核了报告期发行人核心技术产品收入占营业收入的比例，分析比例变动趋势；获取了发行人核心技术人

员的简历，了解其科研能力；获取了发行人报告期内研发投入明细、研发项目文件等，核查了研发投入情况；查阅了发行人已取得的发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等技术成果以及核心技术列表，了解发行人技术先进性、业务方向和技术水平。

经核查，本保荐人认为，发行人所从事的业务及所处行业符合国家战略，属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新行业。同时，发行人具备关键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营，具有较强的科技创新能力，商业模式稳定，市场认可度较高，社会形象良好，成长性较强，符合相关法律法规对科创板定位的要求。

经核查，本保荐人认为，发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》的规定，具体情况如下：

1、关于发行人符合“最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元”的核查情况

保荐人查阅了发行人与研发相关的内控制度，并对研发费用进行了穿行测试，查看了研发项目的立项文件，取得了发行人研发投入明细，对研发投入的归集进行了核查。

保荐人通过访谈了解发行人的收入确认政策，查阅了发行人营业收入明细，对发行人的客户构成及变动情况进行了分析；查看了主要客户的合同或订单，核查了合同或订单的履行情况，对发行人的主要客户进行了走访和函证；对销售收入执行了穿行测试和截止性测试程序，对主要客户回款情况进行了核查。

经核查，公司2020年、2021年、2022年研发投入累计64,184.45万元，公司2020年、2021年和2022年累计研发投入占累计营业收入的比例为26.84%，符合“最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元”的指标要求。

2、关于发行人符合“研发人员占当年员工总数的比例不低于10%”的核查情况

保荐人取得了发行人的研发人员名单及认定依据，核查了研发人员认定的准确性。

经核查，2022 年末，公司拥有研发人员的数量为 219 人，员工总数为 333 人，占员工总数的比例为 65.77%，符合“研发人员占当年员工总数的比例 \geq 10%”的指标要求。

3、关于发行人符合“应用于公司主营业务的发明专利 \geq 5 项”的核查情况

保荐人查阅了相关发明专利的权属证书，就相关专利的权属、有效期限和法律状态进行了核查；对发行人是否涉及知识产权诉讼纠纷，发明专利有无权利受限进行了核查；对发明人拥有的发明专利在主要产品（服务）的应用情况进行了访谈。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司应用于主营业务的发明专利数量为 162 项，发行人拥有的发明专利均在有效期限内，不存在权利受限或诉讼纠纷的情形，符合“应用于公司主营业务的发明专利 \geq 5 项”的指标要求。

4、关于发行人符合“最近三年营业收入复合增长率 \geq 20%，或最近一年营业收入金额 \geq 3 亿”的核查情况

保荐人通过访谈了解发行人的收入确认政策，查阅了发行人营业收入明细，对发行人的客户构成及变动情况进行了分析；查看了主要客户的合同或订单，核查了合同或订单的履行情况，对发行人的主要客户进行了走访和函证；对销售收入执行了穿行测试和截止性测试程序，对主要客户回款情况进行了核查。

经核查，最近三年营业收入复合增长率为 16.87%，2022 年营业收入为 8.95 亿元，符合“最近三年营业收入复合增长率 \geq 20%，或最近一年营业收入金额 \geq 3 亿”的指标要求

综上，经核查，发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》的规定。

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《注

册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，结果如下：

1、发行人的设立时间及组织机构运行情况

保荐人查阅了发行人的工商档案、有关主管部门出具的证明文件、纳税资料等。发行人自 2016 年 9 月 28 日成立以来持续经营并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的有关规定。

2、发行人财务规范情况

保荐人查阅了发行人财务报告、发行人会计师出具的《审计报告》等相关财务资料，并取得了财务相关的内外部文件。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3、发行人内部控制情况

保荐人查阅了发行人会计师出具的内部控制鉴证报告、内部控制制度等资料，并与发行人相关人员进行了访谈。经核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4、发行人资产完整性及人员、财务、机构独立情况

保荐人查阅了发行人主要资产的权属证书、重大业务合同、《审计报告》、三会文件等资料。经核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与第一大股东及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

5、业务、控制权及主要人员的稳定性

保荐人查阅了发行人三会文件和花名册、发行人会计师出具的《审计报告》

等资料。经核查，最近 2 年内发行人主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；最近 2 年内发行人核心技术人员稳定且最近 2 年内没有发生重大不利变化；发行人第一大股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年发行人不存在实际控制人，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

6、对发行人持续经营有重大不利影响的事项

本保荐人查阅了发行人重要资产的权属证书、银行征信报告、信永中和会计师事务所出具的《审计报告》等资料，并查询了中国裁判文书网等公开网站信息。经核查，发行人不存在影响持续经营的主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷、重大偿债风险或重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项，符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

7、发行人经营合法合规性

本保荐人查阅了发行人会计师出具的《审计报告》、发行人相关业务合同，并与发行人相关人员进行了访谈，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

8、发行人、第一大股东的守法情况

本保荐人取得了发行人相关主管部门出具的合规证明及发行人第一大股东出具的说明文件，并查询了国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等网站。最近 3 年内，发行人及其第一大股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

9、董事、监事和高级管理人员的守法情况

本保荐人对发行人相关人员进行了访谈，取得了发行人董事、监事和高级管理人员分别出具的调查表，并通过国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台进行查询。经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件。

（二）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

本次发行前，发行人的股本总额为 36,000.00 万元，若本次公开发行的 4,001.00 万股全部发行完毕，每股面值为人民币 1 元，发行后的股本总额将达到 40,001.00 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

（三）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上”规定

公司本次发行前股份总数为 36,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，本次拟公开发行不超过 4,001.00 万股每股面值 1 元的股票，发行后总股数不超过 40,001.00 万股。本次发行并在科创板上市完成后，发行人向社会公众发行的股份数将不少于本次发行后股份总数的 10%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定及《上市规则》第 2.1.2 条之“（二）预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”规定

根据《上市规则》2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”。

根据发行人最近一次外部股权融资对应的估值以及可比 A 股上市公司二级市场估值情况，发行人的预计市值不低于 15 亿元，满足所选择上市标准中的市值指标。公司 2022 年度经审计的营业收入为 8.95 亿元，最近三年累计研发投入为 64,184.45 万元，占最近三年累计营业收入 239,111.53 万元的 26.84%。发行人

市值和财务指标符合《上市规则》第 2.1.2 条第二款之规定。

（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

发行人股票上市后，保荐人及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年。

持续督导事项	工作计划
1、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及发行人的报道，督导发行人履行信息披露义务
2、督导发行人有效执行并完善防止第一大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行
3、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程（草案）》的规定，协助发行人制定有关制度并督导其实施
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程（草案）》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金投资项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程（草案）》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定
7、中国证监会、证券交易所及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、上交所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其第一大股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

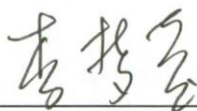
保荐人认为：硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名:



李梦莹

保荐代表人签名:

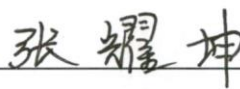


张林



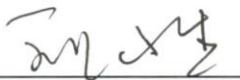
侯顺

内核负责人签名:



张耀坤

保荐业务负责人签名:



刘乃生

法定代表人/董事长签名:



王常青

